



☆【大阪】新規低伝送損失基板材料の要素技術開発及び新商品開発【PID 電子材料事業部】

パナソニックインダストリー株式会社での募集です。電子デバイス研究開発のご経験...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

パナソニックインダストリー株式会社

Job ID

1483675

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Osaka Prefecture

Salary

5 million yen ~ 8.5 million yen

Work Hours

08:30 ~ 17:00

Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 年次有給休暇（年間25日付与、初年度のみ入社月に応じ付与。2021年度平均取得日...

Refreshed

June 21st, 2024 13:38

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Daily Conversation

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2162375】

●担当業務と役割

当事業部が保有しているコア技術は、熱硬化性樹脂の材料設計技術です。

近年、5G/6Gと信号の高速化がますます進展しており、それに適用するため熱硬化性低損失基板の市場が拡大しています。

将来、この事業領域をさらに拡大するためには、樹脂に加えて、無機充填剤/基材/金属箔等の幅広い知識、経験を持った技術者を必要としています。

未来の配線板に適応される新しい材料の開発に加えて、顧客と一緒に新しい市場を切り開いて頂きたいと考えています。

- 具体的な仕事内容
 - ・新規絶縁材料の要素技術開発、商品開発、プロセス技術開発、評価技術開発
 - ・海外を含む顧客対応、顧客ニーズ調査、技術マーケティング活動
- この仕事を通じて得られること
 - ・材料で社会基盤を支えている達成感を得ることができます。材料（商品）の性能向上により、高速通信・省エネルギー・省電力に貢献する機器の実現に貢献 等
 - ・世界のリーディングカンパニーとの信頼関係、人脈構築
- 職場の雰囲気
 - ・リーダークラスには比較的若い世代が多く、中途入社者も数人います。年齢や役職に関係なくフラットに議論・相談を行っている組織です。
 - ・新しいことに挑戦できる、活気のある職場です。実際に自分たちの手足を動かして、スピード感を持って業務にあたっています。
 - ・出張やテレワーク等、個人の裁量に任せられています。
- キャリアパス
 - ・初期配属の部署の仕事にとどまらず、様々な職務を経験することも可能です。
 - ・例えば、初期配属は要素技術開発ですが、商品開発や製造技術を経験することが可能です。米国にも拠点を構えていますので、駐在する可能性もございます。

Required Skills

[経験] ・硬化性樹脂を用いた材料開発および材料設計の経験 [知識] ・化学反応等に関する有機化学の知識 ・一般化学（有機、無機）に関する知識 ・一般化学分析に関する知識 ・低誘電材料に関する知識 [スキル] ・絶縁材料の設計スキル ・材料の配合、混練スキル ・材料の物性評価スキル ・顧客対応スキル

Company Description

電気部品・電子部品・制御機器・電子材料等の開発・製造・販売